

上海南芯半导体科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东的合法权益，公司发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并及时披露了 2025 年半年度评估报告。

为进一步提升公司运营效率与市场竞争力，切实保护投资者合法权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象，公司评估了 2025 年“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、专注主营业务，提升经营质量

2026 年，公司将持续深耕主营业务，进一步加大研发投入力度，推动技术与产品创新，深化客户关系，充分发挥供应链整合优势，全方位提升公司市场竞争力。

1、加大研发投入，增厚研发团队成果

2025 年，公司研发投入 647,145,107.04 元，较上年同期增长 48.23%；研发投入总额占营业收入比例为 19.85%，较 2024 年增加 2.84 个百分点。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员数量增至 840 人，较上年同期增长 48.15%，研发人员数量占公司员工总数的比例为 68.13%。公司获得新增授权发明专利 84 项，累计获取专利 199 项。公司累计有 32 项核心技术，均为自主研发且均在公司产品上实现应用。

2026 年公司将持续深化技术积累，预计保持 2025 年研发投入占营业收入的比例不低于 15%，加大研发投入满足公司日益增长的产品需求，并积极拓宽引才渠道，高效整合研发资源，不断优化人才梯队，为公司的持续增长与长远发展筑牢根基。

2、丰富产品型号，加速拓展汽车、工业和智能算力等应用领域

2025 年，公司在深耕消费电子原有竞争优势领域的同时，报告期内投入大量资源加速拓展汽车、工业和智能算力领域的产品布局，不断完善产品矩阵，丰富业务场景，挖掘持续成长新动力。

在高端消费电子领域，公司全新推出全集成升降压充电芯片（内置 MOS+OTG）、带控制引脚锂电保护芯片、全球首批 Qi2.2 认证 25W 无线充电模组、190V 压电驱动芯片（10 倍节电+国产液冷微泵突破）、AI 眼镜长续航方案（含国内首颗均衡限流 IC）以及多相四路同步降压等，覆盖手机、平板、AI 眼镜、AI PC、边缘计算、智能穿戴等全场景高效电源需求。

在汽车电子方面，公司发布了车规级高速 CAN/CAN FD 协议收发器、ADAS 一站式电源方案（ECU 至传感器端）、全国产垂直 BCD 工艺新一代高边开关、ASIL-D 级 SBC 以及高端 MCU PMIC 等多款车规产品，通过 AEC-Q100 与 ISO26262 双认证，助力智能驾驶、域控制器、智能座舱等方向的国产化创新升级。

围绕工业、智能算力等领域，公司推出 80V/120V 高耐压升降压系列、10 μ A 超低静态电流工业级 Buck、700V 高压 GaN 半桥、大功率 LLC SR 控制器（满足 AI 服务器最高能效标准）、24V 超高性能同步降压，以及人形机器人全链路电源解决方案（含 MPPT 双向充放电+高串电池 Buck+多相 AI 算力电源），有力支撑 AI 算力、储能、机器人、电动工具、通信基站等高增长赛道。

2026 年，公司将深化战略产品布局，加强公司在智能算力领域的电源管理芯片、车载应用的传感、通信、驱动、控制等芯片以及工业应用的传感及控制芯片，加速公司在新领域的业务进展，保持公司长期竞争力。同时，公司将不断加强技术创新，围绕产品核心 IP 和工艺，加强自主研发，打造技术护城河，保障产品的独特性和竞争力，提升产品性能。

3、公司经营稳健发展，多元化业务驱动营收高增长

2025 年，在行业温和复苏的背景下，公司营收展现出强大的增长韧性。公司 2025 年各季度营业收入分别为 685,240,476.74 元、784,906,130.07 元、910,260,198.41 元和 880,132,478.23 元，全年业绩维持稳健增长趋势。2025 年度，公司业务多元化驱动业绩增长，消费电子领域营收规模进一步扩大，占公司营收比例为 89.26%，汽车电子领域业务增长迅猛，年增速达 140.55%，实现 6.31% 营收占比，工业领域业务也体现快速的成长，实现 129.90% 的年增幅，占营收比例 4.24%。

2026 年，公司将在现有汽车业务布局的基础上，加速向海内外主流整车厂和 Tier-1 厂商渗透，扩大现有大客户的份额，提高汽车业务的营收占比。同时，

在智能算力领域和工业领域，公司将坚持大客户市场策略，基于公司在大电流 DC-DC、多相电源、高压电源管理等技术和产品，推动公司在智能算力领域电源、边缘计算、通信基站、储能管理、智能机器人、智能化设备等领域的大客户拓展。高端消费电子领域，公司将围绕 AI 手机、AI PC、AI 眼镜等新兴终端提供全链路电源解决方案，通过技术迭代与升级和推出新产品，持续稳定核心品牌客户份额。综上，2026 年公司将持续以大客户市场策略为核心，提高现有业务的市场份额，加速新兴应用领域业务的市场拓展，推进公司主营业务的稳健增长。

4、加强产业并购，加快拓展公司业务版图

为完善公司产品布局，强化公司在嵌入式领域的技术实力，提高公司的综合竞争优势，报告期内公司完成了对珠海昇生微 100% 股权的收购。收购完成后，公司推进完成了双方业务和团队的深度融合。通过本次收购，公司整合嵌入式开发技术，强化公司在嵌入式领域的研发能力，拓宽了公司现有产品布局，增强了公司产品在细分应用领域的品牌效应，加快了公司拓展整合 MCU 功能的产品解决方案。

2026 年，公司将继续积极关注产业并购整合的发展机会，在确保与公司商业战略高度协同、符合公司长远利益的前提下考虑采用并购加快拓展公司的业务版图，为公司的长期可持续发展注入新动能。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

报告期内，公司坚持严格执行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《上海南芯半导体科技股份有限公司公司章程》《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，开设专户存储，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

公司稳步推进各项重点项目，其中“高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目”、“高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目”及“汽车电子芯片研发和产业化项目”均按计划结项。

2025 年，公司综合考虑市场和行业的发展变化，为满足公司发展战略的规划，公司召开董事会及股东会审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资

金追加投资额以实施募投项目的议案》，将原募投项目“测试中心建设项目”变更成新募投项目“芯片测试产业园建设项目”。

“芯片测试产业园建设项目”计划使用 IPO 募集资金投入 5.70 亿元，已经投入 0.63 亿元。截至 2025 年末，项目投入进度达到 11.11%。该项目通过购置土地自建芯片测试厂房并投入相关测试设备（包括 FT 测试、CP 测试、烧录测试设备等）以支持公司研发的消费、车规和工业类芯片的生产测试需求，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，提升公司产品质量管理水平。

2026 年，公司将围绕自身产品布局，积极推进芯片测试产业园的土建工程和厂房建设，加速对芯片产品测试自有能力的建设，加速该项目募集资金的投入，以实现公司往消费、汽车、工业多领域平台型发展战略，提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模提升。

三、持续完善公司治理，筑牢高质量发展根基

公司高度重视治理水平的提升，2026 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的相关要求，持续推进公众公司的规范运作，进一步完善和优化公司各项治理和管理制度，依法全面履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，提高规范运作水平，筑牢高质量发展根基。

1、持续优化公司各项治理制度。公司积极响应证监会 2026 年施行的《上市公司治理准则》等各项监管规则的要求，修订《公司章程》及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分治理制度，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，通过进一步完善各项治理相关制度，着力构建运作规范、决策科学的法人治理架构。

2、推进环境、社会及公司治理（ESG）体系建设，将 ESG 理念深度融入公司战略规划、经营决策与日常运营，建立 ESG 治理架构与管理机制。积极践行绿色发展理念，强化节能环保、低碳运营与资源高效利用，推动绿色低碳转型；切实履行社会责任，坚守商业道德，保障员工合法权益，积极投身社会公益、乡村振兴等事业，构建和谐共赢的利益相关方关系。

3、持续深化董事及高级管理人员证券法律法规专题培训，建立常态化、系统化学习机制。定期组织董监高人员认真学习证监会、交易所最新发布的监管规

则、指引及规范性文件，积极参与监管机构、自律组织开展的各类合规培训与专题教育，持续强化资本市场法律法规、公司治理、信息披露等专业知识与合规理念，不断提升董事、监事及高管人员的履职能力、规范运作意识与风险防范水平，为公司持续健康、高质量发展提供坚实保障。

四、加强投资者沟通交流，建立长期互信通道

自上市以来，公司始终高度重视投资者关系管理工作，持续构建多元化的投资者沟通平台，通过投资者热线、上证 e 互动、公司官网投资者关系专栏、业绩说明会及股东大会等多种形式，增进投资者对公司经营发展情况的认知，与投资者保持高效良性互动。公司切实维护投资者的知情权，清晰传递公司价值理念与发展逻辑，为股东决策提供真实、准确、完整的信息支撑。

2026 年，公司将持续深化与投资者的沟通互动，积极建立高效顺畅的资本市场沟通机制，着力构建规范、透明、良性的投资者关系管理体系，不断优化沟通路径、丰富交流形式。计划通过“上证路演中心”“进门财经”等平台开展不少于 6 场投资者线上交流活动，组织接待投资者实地调研不低于 24 次；同时依托投资者热线、e 互动平台、电子邮箱、策略交流会等多元渠道，提升沟通频次与响应效率，积极回应股东合理诉求与市场关注焦点，打通信息传递障碍，帮助投资者更深入、清晰、全面地认知公司内在价值，进一步提升投资者认同感与信心。

公司将持续健全投资者意见征集与反馈闭环机制，强化信息披露透明度，精准把握投资者核心诉求并开展针对性回应。在严守合规底线的前提下，确保投资者全面、及时掌握公司经营动态与发展战略，持续深化双向沟通，不断夯实投资者信任基础，凝聚长期发展共识。

五、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终将投资者利益置于优先地位，以持续、稳定的现金分红切实保障全体股东权益。结合公司盈利水平、现金流状况及未来发展规划，科学制定合理的利润分配方案。

2025 年，根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司以权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专户股数 423,950,022 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利总额为 84,790,004.40 元（含税）。

2026年4月28日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股数为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利106,477,570.25元。公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本议案尚需提交股东会审议。

未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，将密切关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。

六、强化管理层与股东的利益共担共享

2025年5月7日，公司股东会审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2025年5月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对公司核心员工共计277位同事首次授予239.4394万股限制性股票。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象预留授予限制性股票的议案》，对公司核心员工共计94位同事授予54.90万股限制性股票。

2026年3月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟对公司核心员工共计373位同事授予286.1467万股限制性股票，本议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

公司对激励计划设定了公司层面营收收入的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

此外，公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基础薪资、津贴及绩效奖金组成。公司依据经营业绩及盈利状况，结合个人绩效目标完成情况进行评估，确定高管的绩效奖金。绩效奖金与公司及个人绩效挂钩。公司绩效指标包括销售额、毛利润、净利润、产品开发、客户拓展情况、投产计划、生产质量、研发项目、组织人才等，对公司经营进行全面评估。个人

绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。2026年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

七、其他事宜

公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的相关措施进行审慎评估，并按规定及时履行信息披露职责。未来，公司将始终聚焦主营业务，持续提升经营管理水平与运营效能，以稳健的经营业绩与规范的公司治理，切实履行上市公司应尽职责，回馈投资者的信任与支持。同时，公司将继续维护良好的市场形象，助力资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月28日